

レーザ微細加工技術の最新動向

近年、レーザ微細加工技術は、光源の高出力化・短パルス化、ビーム制御技術や加工プロセスの高度化により、精密加工の可能性を大きく拡げています。金属加工をはじめとして、半導体、電子デバイス、医療機器、次世代材料加工など幅広い分野で応用が進み、研究・産業の両面で注目を集めています。本研究会では、レーザ微細加工技術に関する最新の研究成果や実用化事例を、第一線で活躍する4名の研究者と技術者から最新情報をご提供頂くとともに、今後の技術展開や課題について議論します。

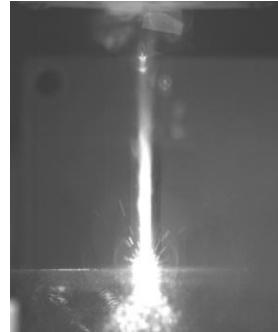
主 催：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日 時：2026年2月20日(金) 13:00～17:00

開催方式：下記会場（対面）とCisco Webex Meeting（Web）のハイブリッド形式で開催します。

日本大学理工学部駿河台キャンパス 1号館6階CSTホール

URL：<https://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/surugadai/>



※ 講演者には開催前の状況により、対面かWebのどちらでの講演かを選択して頂きます。

※ Web開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。

13:00～13:05 開会挨拶

委員長 日本大学 山田 高三 氏

13:05～13:55 講演1 次世代レーザ加工に向けたアクティブ制御レーザ加工技術開発（仮題）

産業技術総合研究所 吉富 大 氏

13:55～14:45 講演2 微細加工を行う選択肢としてのレーザという加工ツール（仮題）

(株)アルプスエンジニアリング 刀原 寛孝 氏

14:45～15:05 <休憩>

15:05～15:55 講演3 超短パルスレーザによる微細加工技術や事例（仮題）

(株)リップス・ワークス 照井 正人 氏

15:55～16:45 講演4 次世代半導体ガラス基板への微細レーザ加工（仮題）

東京大学 物性研究所 小林 洋平 氏

16:45～16:55 閉会挨拶・事務連絡

17:10～19:10 技術交流会（予定）

司会：森田晋也（東京電機大学）、山田洋平（埼玉大学）、小山宏（日本工業出版）

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料、非会員：15,400円（税抜額 14,000円+消費税 1,400円）、非会員アカデミア：6,600円（税抜額 6,000円+消費税 600円）、学生：無料

※会員は5人/社まで、非会員は2人/社まで研究会に参加できます。

技術交流会：会員資格に関わらず2名/社まで参加できます。3人目からは4,950円/人（税抜額 4,500円+消費税 450円）を徴収します。

(注)「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意下さい。

申込締切日：2026年2月6日(金)

(注)当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：当専門委員会事務局

・FAX：048-858-3709, E-mail : sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

・申し込みはホームページよりお願ひいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>